

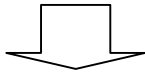
短時間硬化(世界最速)接着剤

—ボリウム商品対応—

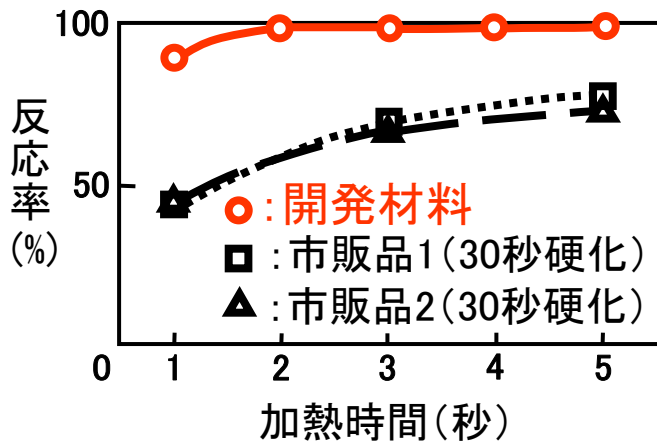
Auバンプ方式は一括リフロー不可:FCボンダ上での硬化が必須
低コスト化、生産能力UPには硬化時間短縮が不可欠

材料設計

反応速度の速い硬化促進剤を設計



自己発熱の蓄積で接着剤内部温度を上昇

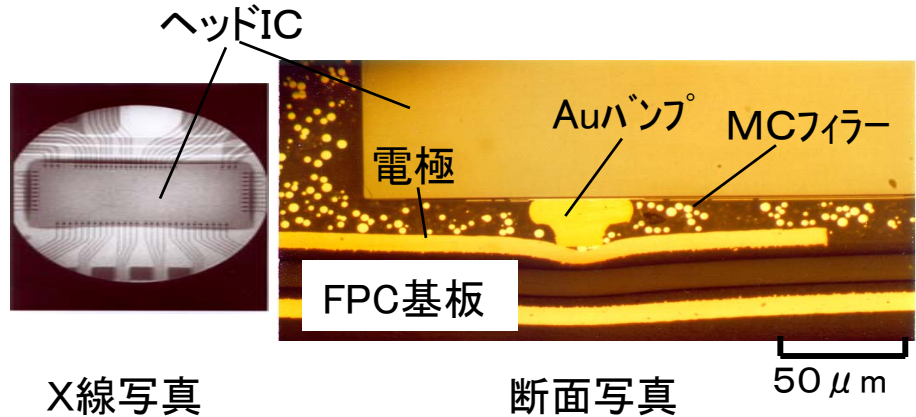


硬化時間短縮: 30秒 → **3秒**

HDDヘッドアンプIC、携帯電話用カメラCMOSチップ接合に実用化

接合信頼性の確保

条件: 195°C, **3秒**, 20g/bump



温度サイクル: -65°C ~ 125°C, 1000サイクル
高温高湿バイアス: 85°C, 85%, DC5V, 1000h
高温放置: 150°C, 1000h

要求信頼性満足